

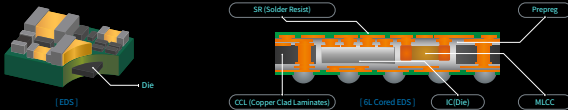
BGA (EDS)

개요

OVERVIEW

IC 및 수동소자를 내장하는 Module용 기판

- Module 사이즈 감소 및 최단 Path 연결로 Noise 개선 가능
- 응용 분야 : Mobile Power Module, 전장용 등



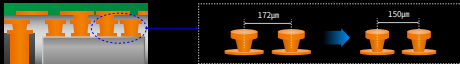
핵심 기술

CORE TECHNOLOGY

Multi-Die/
Multi-Passive
Integration 가능



Bump Pitch 미세화



주요 사양

KEY SPECIFICATIONS

Chip Thickness		100µm
Chip / PKG Ratio		Max. 50%
Substrate	Bump Pitch	172µm
	Via Size	65µm